

Elastyczna, szybkowiążąca,
cementowa zaprawa klejąca

PCI FT[®] Rapid

do wszystkich okładzin ceramicznych



Zakres stosowania

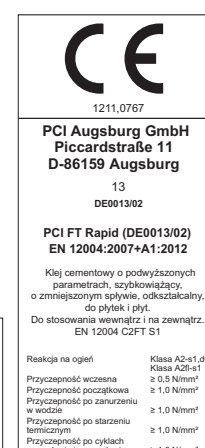
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian i posadzek.
- Do wyklejania we wnętrzach i na zewnątrz budynków chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych, gresu itp. na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych, jak np.: beton monolityczny, tynki cementowe, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe, jastrychy i wylewki cementowe i anhydrytowe, lastriko, płyty kartonowo-gipsowe, cementowo-włóknowe i OSB, zespolone uszczelnienia podpłytkowe (np. PCI Lastogum[®], PCI Seccoral[®], PCI Barraseal[®], PCI Apoflex[®], PCI Pecilastic[®]), stare powłoki malarskie i stare okładziny płytkowe, ogrzewania podłogowe i ścienne.
- Do klejenia płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia.
- Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych i mokrych (łazienkach, umywalniach), na balkonach, tarasach, fasadach nieocieplonych i ocieplonych, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływackich, na posadzkach narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane zmianami temperatury.
- Do wyrównującego szpachlowania podłoży mineralnych w zakresie grubości 1 do 5 mm.
- Do przyklejania na podłożach betonowych, murowanych i tynkowanych płyt styropianowych obwodowego ocieplenia podziemnych części budynków.
- Do przyklejania płyt styrodurów i z wełny mineralnej.
- W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.
- Do wykonywania robót płytkarskich w warunkach presji czasowej.



Klej PCI FT[®] Rapid umożliwia błyskawiczny postęp prac.

Właściwości produktu

- Odpowiada klasie C2FT S1 wg normy PN-EN 12004.
- **Brak spływu** na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia.
- **Mrozo- i wodoodporna.**
- Do warstw o grubości: 1 do 5 mm.
- Wykazuje **wysoką przyczepność** do różnych podłoży i różnych okładzin, także niechłonnych i gładkich (np. beton monolityczny wykonany w gładkim deskowaniu, płytki gresowe).



Właściwości produktu

- **Wysoko-elastyczna (S1)** – kompensuje znaczne odkształcenia podłoża wynikające np. ze dużych zmian temperatury.
- **Plastyczna** - łatwa w obróbce.
- **Szybkowiążąca** - już po 3 godzinach w temperaturze pokojowej umożliwia wchodzenie i spoinowanie.
- **Ekologiczna** - oznaczona znakiem **EMICODE EC1 PLUS**.

Dane techniczne

Baza materiałowa	sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i dodatków	
Składniki	produkt 1-składnikowy	
Konsystencja	plastyczna	
Kolor	szary	
Składowanie	w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C	
Trwałość składowania	6 miesięcy	
Opakowanie	wzmocniony worek papierowy 25 kg z wkładem polietylenowym nr art./EAN 3920	
Zużycie/wydajność:*		
Paca zębata	Zużycie/m ²	Worek 25 kg wystarcza na ok.:
6 mm	2,3 kg	10,8 m ²
8 mm	2,9 kg	8,6 m ²
10 mm	3,2 kg	7,8 m ²
Temperatura aplikacji i podłoża	+5 °C do +25 °C	
Ilość wody zarobowej:		
- na 1 kg suchej mieszanki	ok. 0,26 l	
- na worek 25 kg	ok. 6,5 l	
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty	
Czas użycia**	ok. 40 minut	
Czasy utwardzania:**		
- możliwość wchodzenia po	ok. 3 godzinach	
- pełne obciążenie po	ok. 3 godzinach	
- możliwość spoinowania po	ok. 1 dniu	
Grubość warstwy kleju	1 do 5 mm	
Czas otwarty klejenia	ok. 15 minut	
Odporność termiczna	-30 °C do +80 °C	
Przyczepność wczesna	≥ 0,5 N/mm ²	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²	
Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0/A2fl-s1	

* Na zużycie PCI FT® Rapid wpływa wielkość i struktura tylnej strony zastosowanej okładziny oraz stopień wyrównania podłoża.

W praktyce zużycie może wykazywać odchylenie od podanych wartości.

** Przy +23 °C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
 - jastrych PCI Novoment® M1 plus: ok. 24 godziny;
 - jastrych PCI Novoment® Z3: ok. 3 dni;
 - tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;
 - tradycyjne tynki cementowe: ok. 28 dni;
 - beton: ok. 3 miesiące.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Do wyrównywania posadzek zaleca się użycie masy poziomującej PCI Pericem®. Do równania ścian i sufitów można użyć mas szpachlowych PCI Pericret®, PCI Polycrret® K40, PCI Polycrret® K30 Rapid, PCI Nanocret® R2 lub PCI Nanocret® FC.
- Silnie chłonne podłoża cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1 : 1 lub 1 : 2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1 : 1 z wodą. Podłoża gipsowe zagruntować nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.
- Podłoża niechłonne (np. stare farby olejne, stare okładziny płytkowe, lastryko, płyty OSB) należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® 404 lub PCI Gisogrund® 303.
- Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych gruntować środkiem PCI Wadian®.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność szczątkowa, mierzona metodą CM, powinna wynosić dla:
 - podłoży cementowych: 4 %;
 - dla podłoży gipsowych: 0,5 %.

Sposób użycia

Przygotowanie zaprawy klejowej

- 1 Wlać do czystego naczynia odpowiednią ilość wody zarobowej. Wsypać zawartość opakowania i wymieszać odpowiednim mieszadłem (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej zaprawy.
- 2 Odczekać ok. 3 minuty i powtórnie krótko wymieszać.

Wyklejanie okładzin

- 3 Najpierw gładką stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową.
- 4 Następnie odpowiednią pacą zębatą nanieść (możliwie w jednym kierunku) na świeżą warstwę kontaktową zaprawę klejową. Nanosić tylko tyle zaprawy, ile można obłożyć płytkami w czasie otwartym klejenia. Opuszką palca kontrolować czas naskórkowania zaprawy.

- 5 Lekko posuwistym ruchem ułożyć płytki na zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

Spoinowanie

- Do wypełnienia spoin użyć odpowiednich zapraw spoinowych, np. PCI Nanofug®, PCI Nonofug® Premium czy PCI Durapox®.
- Spoiny dylatacyjne wypełnić właściwymi uszczelniaczami, np. PCI Silcofug® E lub PCI Elritan®.

Zalecenia i uwagi

- W przypadku wyklejania kamieni naturalnych wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia należy używać dedykowanych do tego zapraw klejowych PCI Carrament®.
W razie wątpliwości co do właściwości danego kamienia, zaleca się wykonanie próbnego przyklejenia i na tej podstawie dobrać odpowiedniej zaprawy klejowej.
- Na balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniach podłogowych i ściennych, w basenach pływakich i kąpielowych oraz w przypadku okładzin płytkowych poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym (np. naciskom kół pojazdów czy podpór ciężkich elementów wyposażenia), należy zastosować klejenie metodą kombinowaną lub użyć zaprawy płynnowarstwowej PCI Flexmörtel® S1 Flott, celem zapewnienia podklejenia min. 95 % powierzchni płytki.
- Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym należy przed wyklejaniem okładzin płytkowych poddać wstępnemu wygrzewaniu.
- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą zaprawą.
- Nie dodawać do zaprawy klejowej żadnych substancji poza czystą wodą zarobową.
- Jeśli nie ma innych wymagań, należy zapewnić podklejenie zaprawą klejową min. 65% powierzchni płytki.
- W przypadku klejenia na ścianie płytek o dużym ciężarze powierzchniowym, można zredukować ilość wody zarobowej do 0,24 l/kg suchej mieszanki. Wiąże się to jednak ze skróceniem czasu otwartego klejenia.
- Przed spoinowaniem usunąć spoimiędzy płytek jeszcze w stanie świeżym resztki zaprawy klejowej.
- Płyty termoizolacyjne mogą być generalnie przyklejane metodą „na placki”, chyba, że przewiduje się na nich dodatkowe warstwy materiałów.

Zalecenia i uwagi

Wówczas konieczne jest przyklejanie pełnopowierzchniowe.

- Przed przyklejaniem płyt styrodurówch należy przetrzeć ich spodnią powierzchnię szczotką drucianą w celu poprawy przyczepności zaprawy klejącej.

- Nie stosować do przyklejania płyt styropianowych na podłożach bitumicznych.
- W przypadku klejenia płyt termoizolacyjnych na sufitach stosować dodatkowe dyblowanie ich do podłoża.

- Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu, gdyż później może być konieczne czyszczenie mechaniczne.

Wskazówki BHP

Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać pyłu.

Zanieczyszczone oczy przenieść natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przenieść zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie

rękawice ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych rozszerzeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.